

数学与系统科学研究院

计算数学所学术报告

报告人： 周振亚 研发总监

( 北京华大九天软件有限公司 )

报告题目：

大规模并行晶体管级电路仿真  
中的数学问题

邀请人： 崔涛 副研究员

报告时间： 2018 年 5 月 8 日 (周二)

下午 15:00-16:00

报告地点： 数学院南楼七层

714 教室

## 摘要:

随着集成电路制造工艺的发展，芯片的特征尺寸不断地缩小，寄生器件对电路性能的影响也变得越也来越显著，电路后仿真成为集成电路设计验证不可缺少的关键技术。但是集成电路规模的不断增大，寄生器件数目急剧膨胀，电路后仿真中求解非线性代数方程组所需要的时间大幅增加，导致电路验证时间越来越长，影响集成电路的设计周期和产品交付时间。同时由于工艺偏差引起的成品率问题也越来越严重，需要集成电路设计工程师在芯片设计之处就需要考虑设计参数片上偏差的影响，对设计参数进行优化，以提高成品率，尤其是对于大规模阵列电路，成品率的验证和优化问题更为突出。

# 欢迎大家参加！